



北海道

令和7年度半導体関連産業に係る複合拠点化事業

参加者
募集中

半導体関連産業 参入促進セミナー

北海道では、Rapidus株式会社の立地を契機として、道内企業の半導体関連産業への参入を促進するための取組を進めています。本セミナーでは、半導体関連産業への新規参入事例や半導体関連企業からの発注案件の事例の紹介を行うとともに、商談交流会を開催し、新たなビジネスを検討する機会を提供します。

開催日時

2025年12月15日(月)

開場 12:45 / 開演 13:15 ※16:00 閉会予定

開催会場

北海道新聞社1階
DO-BOX EAST

〒060-8711 北海道札幌市中央区大通東4丁目1番地

対象

ものづくり企業など、半導体関連産業への
参入を検討している道内企業

定員

100名

参加無料

申込みは先着順となります。

※オンラインでの配信も実施します。(事前申込みが必要となります)

お申込方法

右記の2次元コードより、「現地参加」または
「オンライン参加」のどちらかご希望の参加
方法を選択の上、お申し込みください。



<https://survey.zohopublic.jp/zs/umBYOz>

講師

株式会社産業タイムズ社

事業開発部 部長 もたい 甕 秀樹 氏

ソマール株式会社

代表取締役社長 曾谷 太 氏

株式会社ジェイ・イー・ティー

取締役CFO兼CSO 伊藤 聡 氏

株式会社レゾナック

エレクトロニクス事業本部
パッケージングソリューションセンター
JOINT2チームリーダー 加藤 禎明 氏

商談交流会 セミナー終了後(希望者のみ)

講師との名刺交換・簡易商談

(現地参加者のみご参加いただけます)

お問い合わせ

令和7年度半導体関連産業に係る複合拠点化事業
(半導体関連産業参入促進セミナー)受託者
株式会社北海道新聞社 / 担当: 大和
電話: 011-210-5902 10:00 ~ 17:00 (土日祝除く)

主催: 北海道

協力: 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター / 一般社団法人北海道機械工業会

半導体関連産業参入促進セミナー

プログラム

13:15～13:20	開 会 主催者あいさつ	北海道経済部	AI・DX推進局次世代半導体戦略室 室長	浦田 哲哉
13:20～13:40	講演① 日本における半導体産業～先進地域の集積事例に学ぶ～	株式会社産業タイムズ社	事業開発部 部長	もたい 甕 秀樹 氏
13:40～14:10	講演② 地方企業とのジョイントビジネス	ソマール株式会社	代表取締役社長	曾谷 太 氏
14:10～14:40	講演③ 半導体工程(前工程洗浄)における使用パーツ	株式会社ジェイ・イー・ティー	取締役CFO兼CSO	伊藤 聡 氏
14:40～15:10	講演④ 先端パッケージ評価コンソーシアム JOINT2:開発進捗と技術課題の報告	株式会社レゾナック	エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター 外部連携グループ JOINT2チームリーダー	加藤 禎明 氏
15:10～15:15	取引拡大支援に関する紹介	公益財団法人北海道中小企業総合支援センター		
15:15～16:00	商談交流会(講師と現地参加者 希望者のみ) ※名刺交換・簡易商談			
16:00	閉 会			

講 師 紹 介



株式会社産業タイムズ社

事業開発部 部長

もたい

甕 秀樹 氏

半導体メーカー、半導体業界誌記者を経て、2002年に株式会社産業タイムズ社に入社。「半導体産業新聞(現:電子デバイス産業新聞)」副編集長(2008年～2010年)、「週刊ナノテク」編集長(2003年～2007年)、「環境エネルギー産業情報」編集長(2010年～2014年)を歴任し、2014年3月より現部署に。「これが半導体の全貌だ」(共著、かんき出版)などを執筆。

<会社紹介>

株式会社産業タイムズ社は、半導体や電子デバイスの業界紙「電子デバイス産業新聞」を軸に、産業界の「設備投資」を柱とした情報を提供する総合的なメディア企業です。

<講演内容>

半導体産業が日本でどのように根付いてきたかについて、国内の先進地域の産業集積事例を交えながらご紹介します。



株式会社ジェイ・イー・ティー

取締役CFO兼CSO

伊藤 聡 氏

1988年3月 三協エンジニアリング株式会社(エス・イー・エス株式会社に社名変更)入社 2009年5月 株式会社FIT設立 代表取締役就任 2022年4月 株式会社ジェイ・イー・ティ入社 経営企画室担当部長 2023年7月 株式会社ジェイ・イー・ティ・アグリ代表取締役社長(現任) 2024年1月 株式会社ジェイ・イー・ティ経営統括本部長 2024年4月 執行役員経営統括本部長 2025年1月 執行役員CFO兼CSO 経営管理本部管掌 2025年3月 取締役CFO兼CSO(現任)

<会社紹介>

半導体の製造工程において付着する様々な異物を除去する役割を担っている洗浄装置の開発・製造。また、電池の検査・製造装置も手掛けています。

<講演内容>

半導体分野への参入を考えているサプライヤー様向けに、半導体製造工程(前工程、後工程)の役割、洗浄装置の詳細、当社洗浄装置に使われるパーツ(一般市販品、製作加工品)について説明し、最後に必ず気を付けて頂きたい点(ゴミや金属汚染は絶対にNG)をご説明します。当社は客先、装置メーカー、サプライヤーの垣根を超えた共創関係の構築を目指しています。

【対象業種】

- ・電気配線業者(制御盤、ハーネス、現地配線可能)
- ・金属製品製造(金属製品、めっき等)
- ・化学工業(樹脂加工)
- ・黒業土石製品製造業(石英加工)
- ・機械設計業者
- ・電気設計(ハード設計、PLC制御設計、PC制御設計)
- ・配管組立ができる場内外注業者(プラント経験者可)



ソマール株式会社

代表取締役社長

曾谷 太 氏

1973年、東京生まれ。早稲田大学で心理学を学ぶ。大学卒業後はカナダに渡り、会計、情報システム等を学ぶ。帰国後、監査法人トーマツに入所。2005年よりソマールの経営に参加。2011年、社長就任。国内外市場の開拓、新事業の推進に尽力。現在に至る。

<会社紹介>

半導体・電子部品や自動車向けの高機能材料・樹脂などの製造。化粧品や食品材料も手掛けており、道内のアイス屋「長沼あいす」ともコラボしています。

<講演内容>

自動車、半導体、製紙、食品、化粧品等の材料の研究開発及び、製造を行っている、化学系商社兼メーカーであるソマール株式会社の概要、歴史及び、地方の会社と取り組んでいる新規ビジネスの概要をご説明致します。



株式会社レゾナック

エレクトロニクス事業本部
パッケージングソリューションセンター
JOINT2チームリーダー

加藤 禎明 氏

2005年に旧日立化成(現レゾナック)に入社。ウェハ／パネルプロセス用感光材料の開発に12年間従事。その後、中国・蘇州に4年間駐在して新材料の研究と感光性製品の開発を担当。2021年に帰国後、パッケージングソリューションセンターに所属。2.xDパッケージの材料・プロセス開発を目的とした新しいコンソーシアム「JOINT2」の設立に携わり、現在に至る。

<会社紹介>

素材企業の昭和電工と、素材を使い機能を生み出す材料企業の日立化成の合併により誕生。半導体に欠かせない様々な材料を手掛けています。

<講演内容>

次世代半導体パッケージ評価コンソーシアムJOINT2における2.xDパッケージの技術開発状況と、インターポーザー・基板の大型化および接続の微細化に伴って顕在化した技術課題についてご報告します。

【対象業種】

- ・機械器具製造(生産用機械器具、計量器、測定器、光学機械・レンズ等精密機械器具等)
- ・電気機械器具製造(電子部品・デバイス・電子回路製造、電気機械器具、情報通信機械器具等)
- ・産業廃棄物処理